

Epoxy 작용기 첨가에 따른 폴리이미드의 열적 특성 변화 비교

김광인, 한학수*

연세대학교

(hshan@yonsei.ac.kr*)

폴리이미드는 다이엔하이드라이드와 다이아민의 결합으로 생성가능한 높은 열적 안정성을 지닌 고분자이기 때문에 무기재료에서 발생하는 깨짐현상과 뒤틀림현상을 크게 감소시킨다. 이번 연구에서는 전자산업의 주요 유기 고분자 재료로 주목받는 폴리이미드에 에폭시 구조를 첨가하여 열적 물성을 증가시키기 위한 연구를 진행하고자 한다. 각각의 폴리이미드가 제대로 합성되었는지를 IR과 XRD를 사용하여 확인할 것이고 열적 내성이 증가하였는지 확인하기 위해 TGA와 DSC로 T5%와 Tg를 측정하고자 한다.